

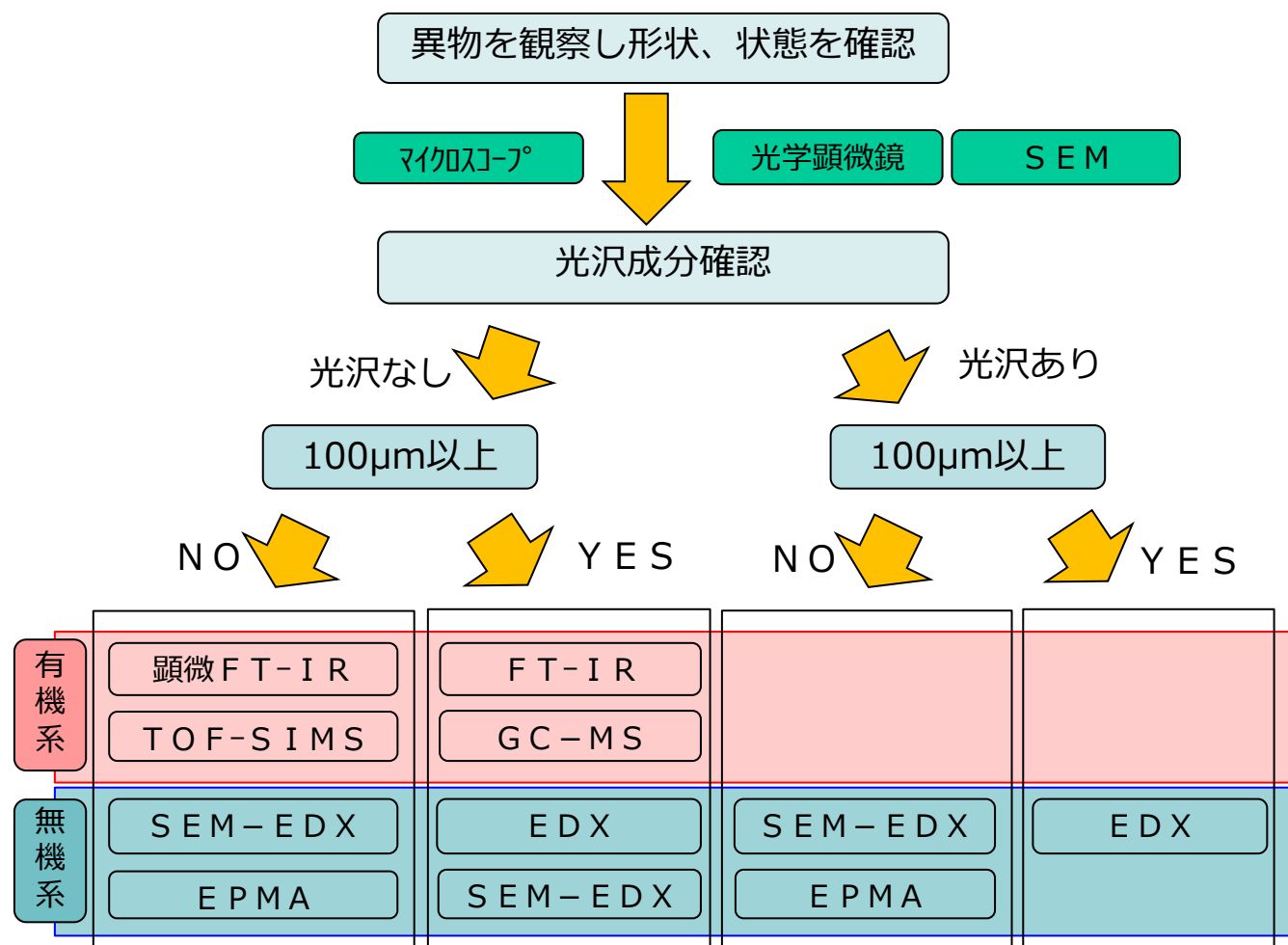
基盤などの不具合の原因を究明します

異物解析

詳細はこちら http://www.oeg.co.jp/env_meas/sub.html

概要 電子部品（プリント基板やコネクタ等）で発生する導通不良や、光学レンズのくもり等、不具合原因の多くは異物によるものです。異物を定性分析する事により、その物質の混入した経路や経緯を特定し、不具合原因の解析を行います。

- 特長**
- 異物の性状に合わせた適切な分析手法の選定します
 - 得られた結果から不具合原因を特定します
 - 不具合原因の対処方法をご提案します



走査型電子顕微鏡 (SEM)



電子線マイクロアナライザ (EPMA)

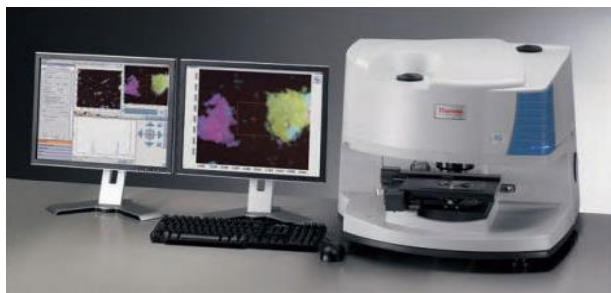


ガスクロマトグラフ 質量分析装置 (GC/MS)



赤外分光分析装置 (FT-IR)

「解析バリエーション強化」 赤外分光分析（FT-IR分析）装置のご紹介

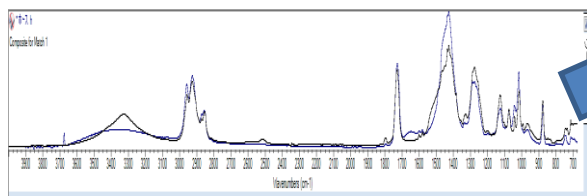


バリエーション強化解析例

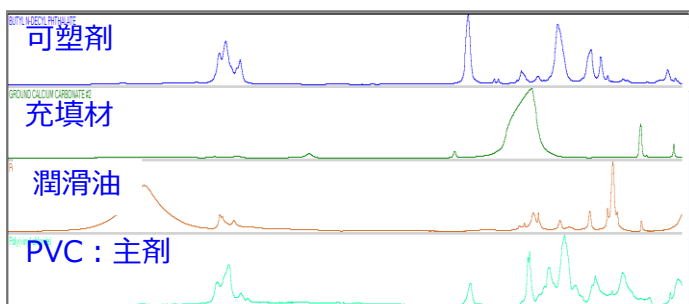
- ・ 最小3μmまでの異物の定性
- ・ 積層構造物の分析
- ・ 規格に基づいた試験後の実際の劣化具合の評価
- ・ マッピング解析により成分の分布の把握
- ・ 主体成分の評価 + 添加剤、複合成分の解析

従来の分析結果と新規設備の分析結果 例：ゴムの定性分析

従来の結果

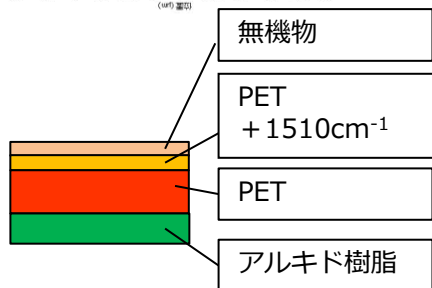
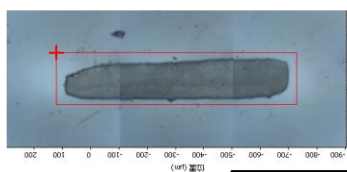


新規設備の分析結果

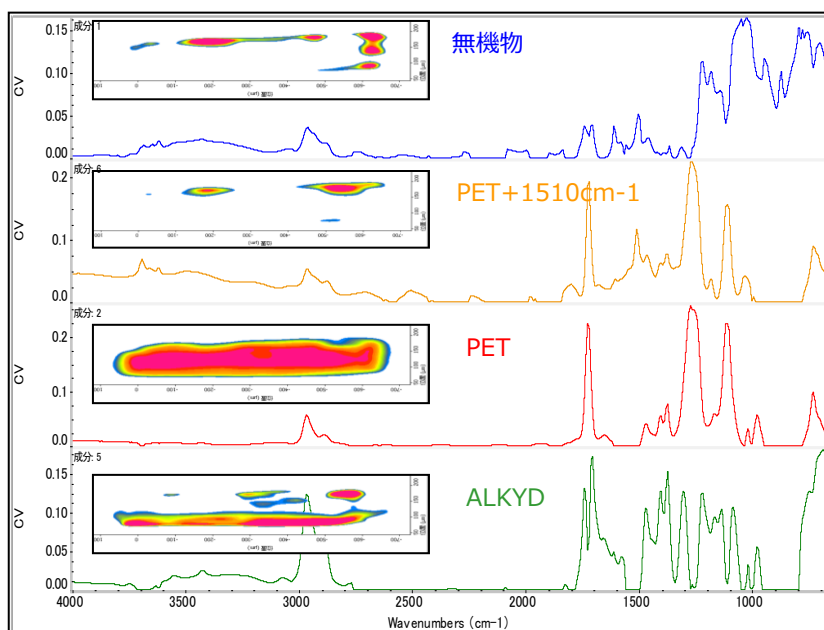


従来では複合した成分の判別が難しく、主体成分のみの解析結果しか出せませんでした。設備導入により複合成分の解析が可能となり、詳細な解析結果のご提供が可能になりました。

マッピング解析の提案 例：塗装片の解析例



塗装片について、4層の分布がある事が確認できました。



マッピング解析をする事によって、積層構造物の解析、見た目では分からない化学成分の存在の把握、汚れの拡散状態、多成分の重なりや範囲の把握が可能になりました。